证券代码：688130　　　　证券简称：晶华微

杭州晶华微电子股份有限公司 2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	46,099,048.57	37,040,423.65	24.46
利润总额	-4,591,887.45	-10,354,012.45	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-4,410,465.97	-10,139,213.96	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,236,275.59	-12,882,507.99	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-36,329,283.14	-19,288,867.49	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.08	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.08	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.35	-0.80	增加0.45个百分点
研发投入合计	19,871,477.83	22,286,093.29	-10.83
研发投入占营业收入的比例(%)	43.11	60.17	减少17.06个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,280,325,525.41	1,308,980,749.56	-2.19
归属于上市公司股东的所有者权益	1,236,791,061.23	1,239,149,246.98	-0.19

注：2025年6月公司实施2024年度权益分派，向全体股东每10股以资本公积金转增3股。根据《企业会计准则第34号》的第13条规定，按照调整后的股数重新计算往期每股收益，故对2025年第一季度基本每股收益及稀释每股收益进行调整。

2026年一季度经营情况简介

一季度为消费电子传统淡季，但随着前期推出新产品（带HCT功能的血糖仪专用芯片、新一代信号调理及变送输出芯片等）的持续推广、客户导入并实现规模出货，同时公司加大市场拓展力度，报告期内，公司实现营业收入4,609.90万元，同比增长24.46%。主营业务中，医疗健康芯片产品收入占比为37.36%，工业仪表芯片产品收入占比为38.83%，智能感知芯片产品收入占比为22.52%，电池管理芯片产品收入占比1.29%。公司主营业务毛利率50.57%，其中晶华微主营业务毛利率56.22%，子公司晶华智芯主营业务毛利率30.08%。

除营业收入增长外，报告期内公司归属于母公司所有者的净利润及扣非净利润实现同比较大幅度减亏的主要原因系：(1)公司持续优化库存结构，提升存货管理能力，前期存货产生的资产减值准备转回较多；(2)公司持续重视研发投入，但受项目流片时间、工艺平台与节点差异影响，本期研发材料费同比有所下降。本报告期公司股份支付费用205.23万元，剔除股份支付费用影响后，归属于上市公司股东的净利润为-235.82万元。

报告期内，公司研发项目进展顺利，比如专用于动态血糖监测的3V双通路模拟前端芯片项目已完成样片测试，性能良好，目前正在进行样机开发与应用验证；专用于电机驱动的带有I/O全映射和8051核的高性价比MCU芯片项目，电动工具方案已完成开发，并获得客户认可，该芯片也可与公司BMS AFE芯片配套，为客户提供一站式解决方案。市场销售方面，公司新一代信号调理及变送输出芯片在压力传感器、温度传感器、液位传感器等应用的基础上，已成功导入机械臂、机器人力传感器应用；晶华智芯的78系列高性能触控显示智能控制芯片已在重点客户中陆续验证导入，72JE系列高性价比小家电触控芯片已实现批量出货，并正积极推进导入终端品牌客户。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,790.37	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	234,597.01	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	2,638,716.79	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,876.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-163.09	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	2,825,809.62	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	不适用	
归属于上市公司股东的净利润	不适用	主要系本报告期营业收入增加、研发材料投入减少以及存货跌价转回所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
基本每股收益(元/股)	不适用	主要系本报告期亏损减少所致
稀释每股收益(元/股)	不适用	

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	7,406	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0				
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
吕汉泉	境外自然人	53,158,560	43.97	52,416,000	52,416,000	无	0
罗洛仪	境外自然人	13,030,290	10.78	0	0	无	0
景宁晶殷华企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	8,263,710	6.84	0	0	无	0
罗伟绍	境外自然人	8,190,000	6.77	8,190,000	8,190,000	无	0
上海超越摩尔私募基金管理有限公司－上海超越摩尔股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1,045,384	0.86	0	0	无	0
富诚海富资管－杭州银行－富诚海富通晶华微员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	880,744	0.73	0	0	无	0
虞玉明	境内自然人	877,933	0.73	0	0	无	0
高盛国际－自有资金	境外法人	872,243	0.72	0	0	无	0
刘杰溪	境内自然人	415,980	0.34	0	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	411,401	0.34	0	0	无	0

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
罗洛仪	13,030,290	人民币普通股	13,030,290
景宁晶殷华企业管理合伙企业(有限合伙)	8,263,710	人民币普通股	8,263,710
上海超越摩尔私募基金管理有限公司－上海超越摩尔股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,045,384	人民币普通股	1,045,384
富诚海富资管－杭州银行－富诚海富通晶华微员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	880,744	人民币普通股	880,744
虞玉明	877,933	人民币普通股	877,933
高盛国际－自有资金	872,243	人民币普通股	872,243
吕汉泉	742,560	人民币普通股	742,560
刘杰溪	415,980	人民币普通股	415,980
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	411,401	人民币普通股	411,401
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	401,802	人民币普通股	401,802
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人吕汉泉与罗洛仪系夫妇，罗伟绍与罗洛仪系兄妹关系，罗伟绍为公司实际控制人的一致行动人，景宁晶殷华系吕汉泉实际控制的企业；公司部分高管与核心员工参与战略配售计划。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

注：前10名股东和前10名无限售条件股东中存在回购专户“杭州晶华微电子股份有限公司回购专用证券账户”，报告期末持有的普通股数量为576,760股，根据规定回购专户不纳入前十名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：杭州晶华微电子股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	203,896,770.91	351,789,682.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	689,000,000.00	440,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	84,085.00	84,085.00
应收账款	31,132,680.96	29,299,118.99
应收款项融资	1,413,835.60	1,199,738.65
预付款项	30,833,850.31	16,871,127.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	900,491.35	547,951.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	68,279,526.56	60,625,355.35
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	86,057,543.62	238,874,589.68
流动资产合计	1,111,598,784.31	1,139,291,648.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,770,560.17	8,369,216.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,888,142.52	7,150,779.77
无形资产	22,650,984.26	24,361,899.57
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	124,152,797.04	124,152,797.04
长期待摊费用	1,075,526.76	1,310,786.20
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,188,730.35	4,343,621.15
非流动资产合计	168,726,741.10	169,689,100.63
资产总计	1,280,325,525.41	1,308,980,749.56
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	23,380,344.96	23,380,344.96
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,576,537.00	8,831,605.51
预收款项		
合同负债	1,186,730.21	621,926.25
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,616,096.39	18,412,427.42
应交税费	1,219,900.80	558,619.75
其他应付款	22,370.66	76,489.20
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,382,339.48	3,382,442.17
其他流动负债	137,258.76	69,846.14
流动负债合计	39,521,578.26	65,333,701.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,457,906.39	3,761,400.17
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	554,979.53	736,401.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,012,885.92	4,497,801.18
负债合计	43,534,464.18	69,831,502.58
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	120,891,094.00	120,891,094.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,113,435,131.61	1,111,382,851.39
减：库存股	21,984,727.73	21,984,727.73
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,218,107.66	12,218,107.66
一般风险准备		
未分配利润	12,231,455.69	16,641,921.66
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,236,791,061.23	1,239,149,246.98
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,236,791,061.23	1,239,149,246.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,280,325,525.41	1,308,980,749.56

公司负责人：吕汉泉 主管会计工作负责人：冯勤 会计机构负责人：周芸芝

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：杭州晶华微电子股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	46,099,048.57	37,040,423.65
其中：营业收入	46,099,048.57	37,040,423.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	55,144,598.25	50,678,794.65
其中：营业成本	22,772,640.06	16,904,212.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	148,477.23	98,452.79
销售费用	3,576,770.62	3,542,258.18
管理费用	8,944,343.58	9,049,796.40
研发费用	19,871,477.83	22,286,093.29
财务费用	-169,111.07	-1,202,018.10
其中：利息费用	65,154.38	215,126.83
利息收入	184,045.51	1,547,350.80
加：其他收益	374,165.76	1,583,054.20
投资收益(损失以“-”号填列)	2,638,716.79	1,967,796.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-78,092.32	106,681.33
资产减值损失(损失以“-”号填列)	1,566,539.27	-428,966.09
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-4,544,220.18	-10,409,804.57
加：营业外收入	261.17	66,477.00
减：营业外支出	47,928.44	10,684.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-4,591,887.45	-10,354,012.45
减：所得税费用	-181,421.48	-214,798.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-4,410,465.97	-10,139,213.96
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-4,410,465.97	-10,139,213.96
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-4,410,465.97	-10,139,213.96
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-4,410,465.97	-10,139,213.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,410,465.97	-10,139,213.96
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.08
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：吕汉泉 主管会计工作负责人：冯勤 会计机构负责人：周芸芝

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：杭州晶华微电子股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	48,861,530.47	46,269,973.20
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	29,401.53	694,604.53
收到其他与经营活动有关的现金	328,172.75	2,402,304.50
经营活动现金流入小计	49,219,104.75	49,366,882.23
购买商品、接受劳务支付的现金	44,112,678.60	22,883,483.39
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	34,023,106.34	33,900,871.13
支付的各项税费	1,268,856.26	1,270,108.93
支付其他与经营活动有关的现金	6,143,746.69	10,601,286.27
经营活动现金流出小计	85,548,387.89	68,655,749.72
经营活动产生的现金流量净额	-36,329,283.14	-19,288,867.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	14,936,045.55	368,379.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	180.00	130.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	560,000,000.00	176,000,000.00
投资活动现金流入小计	574,936,225.55	176,368,509.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,059,681.94	4,760,776.06
投资支付的现金		30,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	669,000,000.00	336,000,000.00
投资活动现金流出小计	674,059,681.94	370,760,776.06
投资活动产生的现金流量净额	-99,123,456.39	-194,392,266.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,731,943.41
筹资活动现金流入小计		12,731,943.41
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		203,808.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,940,788.36	2,567,594.02
筹资活动现金流出小计	11,940,788.36	2,771,402.39
筹资活动产生的现金流量净额	-11,940,788.36	9,960,541.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,493.10	-3,310.00
五、现金及现金等价物净增加额	-147,401,020.99	-203,723,903.35
加：期初现金及现金等价物余额	351,295,718.10	681,243,083.14
六、期末现金及现金等价物余额	203,894,697.11	477,519,179.79

公司负责人：吕汉泉 主管会计工作负责人：冯勤 会计机构负责人：周芸芝

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

杭州晶华微电子股份有限公司董事会

2026年4月28日

公司代码：688130　　　　公司简称：晶华微

杭州晶华微电子股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析 四、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。

3、本公司董事会、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2025年度财务报表出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会、审计委员会对2025年度财务报表非标准审计意见涉及事项进行了专项说明，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的专项说明全文。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-42,138,908.05元，母公司期末未分配利润为人民币　19,340,331.93元。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，属于可不进行利润分配的情形。综合考虑公司盈利状况、发展战略、发展规划及资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，经公司审慎研究讨论，拟定2025年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本次利润分配方案已经公司2026年4月28日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

□适用　√不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所 科创板	晶华微	688130	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用　√不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	纪臻	郑末荣
联系地址	浙江省杭州市滨江区长河街道长河路351号4号楼5层A座501室	浙江省杭州市滨江区长河街道长河路351号4号楼5层A座501室
电话	0571-86518303	0571-86518303
传真	0571-86673061	0571-86673061
电子信箱	IR@SDICMicro.cn	IR@SDICMicro.cn

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司主营业务为高性能模拟及数模混合集成电路的研发与销售，主要产品包括医疗健康SoC芯片、工业控制及仪表芯片、智能感知SoC芯片、电池管理芯片等，其广泛应用于医疗健康、压力测量、工业控制、仪器仪表、智能家居等众多领域。从应用领域来看，公司芯片产品主要终端应用具体如下：

1. 医疗健康SoC芯片

公司医疗健康SoC芯片是基于高精度ADC的信号处理SoC技术，包括人体健康参数测量专用SoC芯片、红外测温信号处理芯片、智能健康衡器SoC芯片等，广泛应用于血糖仪、血压计、血氧计、红外测温枪、体脂秤、健康秤等各类医疗健康产品。

(1)人体健康参数测量专用SoC芯片

公司人体健康参数测量专用SoC芯片系专门针对医疗电子领域推出的具有更高性能的SoC芯片产品，其集成了丰富的高性能模拟信号链资源，可单片应用在血压计、血糖仪、血氧仪等家庭用医疗设备上。公司在人体健康参数测量领域的代表芯片为SD9XXX系列芯片，能够使血压计、血糖计、脂肪率测量仪等实现多种人体健康参数测量，其内置多种振荡器时钟源、正弦波发生电路等丰富模拟资源，并带有多种存储单元、数字通讯接口和其他数字外围资源，做到了高度集成化，实现了在单个芯片上完成信号采集、放大、模数转换、数字信号处理、通讯输出、LCD/LED驱动等不同功能，满足了各个细分领域客户的个性化需求，适合于智能传感器、物联网等模拟信号采集和测量应用。此外，公司还推出支持HCT测量技术的血糖仪专用SoC芯片，内置24位高精度ADC和12位DAC、3路轨到轨运放等模拟电路资源，内含8051 CPU核及128K flash、PWM/PFD、LCD驱动、UART/I2C/SPI等多种通讯协议接口、支持OTA功能等数字电路资源，血糖测量精度满足ISO 15197:2013技术规范。同时在外部比例电阻的配合下可构成32倍差分放大，亦可方便地实现血压计等应用方案。

(2)红外测温信号处理芯片

公司是国内极少数拥有红外测温芯片研发及应用方案开发能力的IC设计企业，连续多年大规模量产发货，产品的高可靠性、高稳定性受到了国内外知名厂商的广泛认可。公司红外测温信号处理芯片采用的单芯片SoC技术即可一站式完成信号测量、模数转换、数据处理、内置LCD/LED驱动及通讯传输串口等功能，能够节省外围器件、提高生产效率，为终端客户提供高集成度、高性价比的红外测温解决方案；同时，公司在红外测温领域配备有成熟的应用开发团队，在算法上能够根据不同应用场景的特点对传感器信号和环境温度进行精准补偿，从而进一步提高测量的准确度。

(3)智能健康衡器SoC芯片

公司智能健康衡器SoC芯片主要应用于人体秤、厨房秤、健康秤、智能脂肪秤（蓝牙/WiFi）等各类衡器产品。人体秤、智能脂肪秤、健康秤可为用户提供体重、脂肪含量等健康数据的测量、监测、存储、跟踪，公司在高精度ADC的技术基础上，辅以蓝牙/WiFi模组，开发出综合类健康APP，所有测量数据均可通过APP自动上传至用户终端设备，形成综合的人体健康跟踪监测方案及个人健康档案。厨房秤可用于精准的搭配食品营养，实现个人健康饮食的管理。公司智能健康衡器SoC芯片在技术上主要体现为其高集成度，无需再外加微控制器及显示驱动芯片，并结合相关算法模型，形成了一套完整的单芯片解决方案，能够为客户提供一站式服务。

2. 工业控制及仪表芯片

工业控制及仪表芯片是在工业生产中广泛使用的参数测量芯片，主要用于工业控制过程中各类电压、电阻、压力、热量、机械量参数的测量，从而帮助工业生产过程的安全平稳运行。目前，公司的工控仪表类芯片主要有数字万用表芯片、HART调制解调器芯片、环路供电型4-20mA DAC芯片、信号调理及变送输出专用芯片四大类，主要应用在数字万用表、压力变送器、温度变送器、流量计等工业领域。

3. 智能感知SoC芯片

公司智能感知SoC芯片主要系人体热释红外线感应（PIR）信号处理系列芯片和智能家电控制芯片。

(1)人体热释红外线感应（PIR）信号处理系列芯片能够在较低功耗情况下适应各类环境进行稳定运行，该系列芯片内置高精度ADC及算法单元，可自调整适应当前环境，滤除环境干扰，有效区分人体信号和干扰信号，感应距离远且误动概率远低于传统控制芯片。未来，在物联网快速发展的背景下，公司智能感知SoC芯片的应用场景将不断丰富，市场前景较为广阔。

(2)智能家电控制芯片是智能家电的中枢，通过对外界指令的精确感知，经过一系列的信号传输实现对家电产品的控制。目前智能家电产品的人机交互方式包括机械式、触摸按键式、语音交互式等，公司的智能家电控制芯片产品应用于触摸按键式交互。公司的智能家电控制芯片以环境智能自适应系列技术为核心，具备抗干扰能力强、稳定性好的特点。公司智能家电控制芯片集成MCU、LED显示驱动、ADC、UART串口通信等功能，所需外部元器件数量少，且引脚功能可由开发者自由设定，能够最大限度地为智能家电厂商节约产品设计空间、降低PCBA布线难度、提高设计自由度。

4. 电池管理芯片

电池管理芯片（BMS）是新能源与电力电子领域的核心控制器件，主要用于电池组的实时监测、状态评估及充放电管理，确保电池系统安全、高效、稳定运行。其核心技术包括单体电压/电流检测、温度监控、荷电状态（SOC）估算、均衡管理以及故障诊断等功能，可显著提升电池寿命并预防过充、过放、短路等安全隐患。目前公司研发的BMS芯片涵盖多串电池监控模拟前端芯片和锂电池保护芯片等，可应用于电动工具、平衡车、扫地机器人、电动旋翼机、电动自行车、电动轻型摩托车、电动摩托车、不间断电源系统(UPS)和电网储能等场景。公司产品以高精度、高可靠性、低功耗特性满足工业级应用需求，为电池系统的智能化管理提供全栈解决方案。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

2.2 主要经营模式

集成电路产业链主要包括集成电路设计、晶圆制造、封装测试等环节。按照是否自建晶圆生产线、封装测试生产线，行业经营模式可分为IDM模式和Fabless模式。IDM模式为垂直整合元件制造模式，采用该模式的企业可以独立完成芯片设计、晶圆制造、封装和测试等各垂直的生产环节。Fabless模式为无晶圆厂模式，采用该模式的企业专注于芯片的研发设计与销售，将晶圆制造、封装、测试等生产环节外包给第三方晶圆制造和封装测试企业完成。

公司是专业的集成电路设计企业，自成立以来，始终采用行业通行的Fabless经营模式，专注于集成电路的设计、研发和销售，将晶圆制造、封装测试等环节委托给专业的晶圆制造厂商和封装测试厂商完成。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主营业务为高性能模拟及数模混合集成电路的研发与销售。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业归属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”，行业代码“6520”。

集成电路是一种半导体微型器件，是经过氧化、光刻、扩散、外延、蒸铝等制造工艺，把半导体、电阻、电容等电子元器件及连接导线全部集成在微型硅片上，构成具有一定功能的电路，然后焊接封装成的电子微型器件。

集成电路按其功能、结构的不同，可以分为模拟集成电路和数字集成电路两大类。模拟集成电路又称线性电路，用来产生、放大和处理各种模拟信号（指幅度随时间变化的信号，例如温度、压力、浓度、湿度、声音、流量、光强等）。而数字集成电路用来产生、放大和处理各种数字信号（指在时间上和幅度上离散取值的信号）。

根据世界半导体贸易统计协会（WSTS）发布的2025年全年报告显示，全球半导体市场规模在2025年增长26.2%，达到7,956亿美元，并预计2026年市场规模将逼近1万亿美元。2025年，中国半导体市场保持稳健增长，根据艾媒咨询的统计数据，2025年中国集成电路市场规模达1.69万亿元，同比增长16.6%。工信部2026年1月30日公布的数据显示，2025年全年中国集成电路产量达到4,843亿块，同比增长10.9%。海关总署统计数据显示，2025年中国集成电路出口达2,019亿美元，同比增长26.8%，首次突破2,000亿美元大关并创下历史新高。

集成电路是现代信息产业的基石，是国家大力支持的产业。自二十一世纪以来，我国政府颁布了一系列政策法规，将集成电路产业确定为战略性产业之一，大力支持集成电路行业的发展。为促进国内集成电路产业的发展，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量，制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八方面的政策措施。这些措施将极大地促进国内集成电路产业的发展。另外，国外对于国内集成电路产业限制进一步加强，这增加了国内集成电路产业的不确定性，但是由此带来的国产化进程加速，也为中国集成电路的快速发展带来了历史性的机遇。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内高精度ADC的数模混合SoC技术领域主要参与者之一，在市场和技术方面，国内企业在ADC领域起步较晚，亚德诺（ADI）、德州仪器（TI）等国际知名模拟IC企业基本占据了中高端市场份额。国内从事该领域的IC设计企业相对较少，公司竞争对手主要包括国外的亚德诺（ADI）、中国大陆地区的芯海科技及中国台湾地区的纮康科技（Hycon）、松翰科技（Sonix）等。

公司始终致力于高性能、高品质混合信号集成电路的研发与设计，深耕带高精度ADC的数模混合SoC芯片技术，面向医疗健康、工控仪表、智能家电、电池管理等下游终端应用市场，整合算法及全套解决方案，为客户提供高品质、高性价比的优质产品。公司是浙江省科技厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合认定的高新技术企业，经过多年的自主研发及技术积累，公司在创新产品的研发上形成了显著的优势，拥有多系列完全自主研发的特色产品。其中，公司基于高精度ADC的信号处理SoC技术在红外测温应用、智能体脂秤以及数字万用表等领域始终保持相对领先地位；在工控仪表领域，公司研发的HART IC技术和4-20mA DAC电路及其校准技术实现了国产替代。近年来，凭借技术和产品的优异表现，公司获得国家级“专精特新”小巨人、浙江省“专精特新”中小企业、“浙江省半导体行业创新力企业”等多项荣誉称号。

作为行业领先的专业混合信号集成电路设计及应用方案供应商，公司秉持“与全球伙伴共建万物感知的晶华芯生态”的愿景，凭借突出的研发能力、可靠的产品质量和完善的配套服务，在行业内积累了丰富的客户资源，与乐心医疗（300562.SZ）、香山衡器（002870.SZ）、优利德（688628.SH）等多家行业内知名企业建立了紧密的合作关系，公司芯片产品已进入倍尔康、华盛昌（002980.SZ）等知名终端品牌厂商的供应体系，深受客户广泛认可。公司始终以优秀的产品性价比和服务，持续为客户提供具有竞争力的系统解决方案。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

1.医疗健康市场

(1)医疗电子市场

健康参数测量SoC芯片是公司核心系列产品，其高精度、高性能的特点在医疗电子测量领域被广泛使用。《“健康中国2030”规划纲要》指出，推进健康中国建设，要坚持预防为主，推行健康文明的生活方式，营造绿色安全的健康环境，减少疾病发生。随着国民健康意识的增强，再加上社会老龄化和空巢老人现象的出现，以及大数据和云服务的迅速发展，将会进一步推动家用医疗设备升级和相关智能硬件的发展。

家用医疗设备，即适于家庭使用的医疗设备，是我国医疗设备体系中重要的一部分。常见的家用医疗设备有体温计、血压计、血糖仪等，其主要特征在于操作简单、体积小巧、携带方便，可为用户的健康提供及时精确的数据检测。随着中国人口老龄化程度的加剧以及慢性病人口数量的增长，家用医疗器械市场的需求正在逐步下沉，更多居民开始接触并使用这类产品。

当前，医疗电子市场在政策引导、技术革新及人口结构变化的驱动下，正迎来高速发展期。中国家用医疗器械市场近年来保持高速增长，已成为全球最具潜力的市场之一。根据中商产业研究院发布的《2026-2031年全球及中国家用医疗器械行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》显示，2025年中国家用医疗器械市场规模2,077亿元，预计2026年中国家用医疗器械市场规模2,212亿元。具体细分：根据Knowledge Sourcing Intelligence数据，中国动态血糖仪市场规模预计从2022年的约3.81亿美元增长到2029年的约15.60亿美元，年复合增长率约为22.3%；贝哲斯咨询发布的报告显示，2025年中国可穿戴医疗设备市场规模为537.44亿元，全球可穿戴医疗设备市场规模为1,887.73亿元，预计全球可穿戴医疗设备市场规模在预测期间将会以12.36%的年复合增长率增长并在2032年达到4,267.92亿元。技术层面，健康参数测量SoC芯片已迈入3nm与柔性存算一体时代，深度集成本地AI算法与多模态传感融合技术，实现μW级超低功耗与亚秒级实时分析，广泛应用于无感可穿戴、动态血糖监测等便携式设备。

(2)健康衡器市场

公司智能健康衡器SoC芯片主要应用于人体秤、厨房秤、健康秤、智能脂肪秤等各类衡器产品。随着科技高速发展和应用水平的提高，衡器产品数字网络化、多功能化、集成化、智能化已成为世界衡器工业的发展方向。中国应用高技术含量的先进衡器，还处在依赖进口解决供应的阶段，因此，在技术含量高的衡器产品领域，中国的衡器制造企业有着巨大的发展空间。另外，在健康应用领域，传统测量衡器普遍有着测量数据不够精准、数据无法保存及长期监测等缺点，无法满足目前对数据进行智能化管理、追踪的需要。因此，研发出能够将测量结果数字化显示、存储、跟踪、管理，并具有高精度的智能衡器芯片产品有望成为未来的发展方向。

中国衡器市场规模受到国内外经济环境、国际贸易政策、市场需求等多种因素的影响，但中国衡器行业整体仍保持一定的市场规模和出口竞争力。同时，随着国内消费水平的提升和工业经济的持续增长，衡器产品的国内需求将进一步拉升。未来，随着人们对健康意识的进一步提升，智能健康衡器产品将会迎来较大的市场空间。

2.工业控制及仪表市场

公司的工控仪表类芯片主要应用在多功能数字万用表、压力变送器、温度变送器、流量计等工业领域。仪器仪表产业作为国民经济的基础性、战略性产业，一直是我国在资金、技术、人才方面重点投入的产业。进入21世纪以来，仪器仪表产业在促进我国工业转型升级、发展战略性新兴产业、推动现代国防建设、保障和提高人民生活水平方面发挥的作用越来越显著，行业规模整体呈现增长态势。其中在电子电工仪表领域，数字万用表是用量最大、用途最广的基础测量仪表，被广泛应用于电子、电力、电器、机电设备、轨道交通等行业。

万用表作为电子电工类测试仪表中用量最大的基础测量仪表之一，据Global Info Research最新发布的《2026年全球数字万用表行业市场研究报告》数据显示，2025年全球数字万用表市场规模已达11.7亿美元，2026年市场规模预计突破12.5亿美元，2026-2032年行业年复合增长率维持在6.65%；其中中国市场作为亚太区域核心增长极，受益于工业自动化升级、新能源产业爆发及国产替代加速，2025年国内万用表相关市场规模突破38亿元，同比增长9.2%。根据Future Business Insights的统计数据，2025年全球传感器市场规模为2,410.6亿美元，预计将从2026年的2,584.7亿美元增长到2034年的5,279.4亿美元，预测期内复合年增长率为9.30%。根据中商产业研究院统计数据，2024年中国传感器市场规模为4,061.2亿元，较上年增长11.43%，2025年中国传感器市场规模将达到4,525.3亿元，2026年市场规模将达到5,042.4亿元。

全球压力传感器市场正处于稳健增长通道，2025年市场规模已攀升至122.6亿美元，这一数据较2024年实现稳步提升，预计到2032年将进一步突破164.4亿美元，2025-2032年期间年均复合增长率维持在4.28%。增长动力主要源于多领域的刚性需求，其中工业自动化、汽车电子和医疗健康成为核心拉动引擎，三大领域合计贡献超过70%的市场需求。

全球温度传感器市场在2025年达到93.5亿美元，根据《2025-2030年中国温度传感器行业市场深度研究与战略咨询分析报告》显示，预计到2030年达到126.8亿美元，复合年增长率为6.28%。2025年，中国温度传感器市场规模达到450亿元人民币，并有望在未来五年内以年均复合增长率(CAGR)8.5%的速度稳步增长，至2030年突破670亿元大关。

3.智能家居市场

公司智能感知SoC芯片主要应用于智慧家居及物联网市场。智慧家居立足于家庭住宅、花园、车库等场景，利用综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活相关的设施集成，构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统。具体应用包括自动节能照明装置、门铃系统、智能玩具控制、自动门、自动滴液、感应冲水器等。根据Statista、IDC等权威机构公开统计数据显示，2025年全球家具及家居用品市场规模约7,300亿美元，整体保持稳健增长态势。其中，中国智能家居市场增速显著领先，2025年市场规模约7,900亿元，同比增长约20%，行业正由传统制造全面转向智能智造，智能化成为家居领域最主要的增长引擎。未来，在行业高速增长背景下，智能感知类芯片需求持续提升，公司相关产品具备广阔的市场空间。

4.BMS芯片市场

全球电池管理系统芯片市场在新能源汽车、储能系统及消费电子的驱动下呈现高速增长。近年来，新能源汽车、储能、电动工具及智能家居等领域快速发展，带动全球电池管理系统（BMS）市场持续增长。根据高工产业研究院（GGII）、中国汽车工业协会等行业机构公开数据，全球BMS市场保持20%以上的年均复合增速，储能领域成为重要增长引擎；中国市场增速领先，新能源汽车、储能为核心应用场景，电动工具、无人机、智能家居等新兴应用需求不断提升，行业发展前景广阔。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	1,308,980,749.56	1,427,803,016.08	-8.32	1,293,517,949.53
归属于上市公司股东的净资产	1,239,149,246.98	1,265,250,310.87	-2.06	1,270,595,956.11
营业收入	173,584,709.53	134,845,663.80	28.73	126,805,482.06
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	173,584,709.53	134,845,663.80	28.73	126,805,482.06
利润总额	-45,029,913.65	-10,270,082.81	不适用	-18,850,475.51
归属于上市公司股东的净利润	-42,138,908.05	-10,270,082.81	不适用	-20,350,966.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-91,359,426.42	-27,760,823.18	不适用	-35,102,089.01
经营活动产生的现金流量净额	-44,048,583.31	-9,963,145.43	不适用	36,798,287.48
加权平均净资产收益率(%)	-3.37	-0.81	减少2.56个百分点	-1.57
基本每股收益(元/股)	-0.35	-0.09	不适用	-0.17
稀释每股收益(元/股)	-0.35	-0.09	不适用	-0.17
研发投入占营业收入的比例(%)	55.91	54.12	增加1.79个百分点	62.12

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	37,040,423.65	41,582,142.02	44,547,170.04	50,414,973.82
归属于上市公司股东的净利润	-10,139,213.96	-12,822,510.21	-7,878,981.97	-11,298,201.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-12,882,507.99	-17,046,649.52	-11,218,564.20	-50,211,704.71
经营活动产生的现金流量净额	-19,288,867.49	-7,540,870.43	-6,721,378.79	-10,497,466.60

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	7,723
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,406
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
吕汉泉	12,607,560	53,158,560	43.97	52,416,000	无	0	境外自然人
罗洛仪	3,006,990	13,030,290	10.78	0	无	0	境外自然人
景宁晶殷华企业管理合伙企业(有限合伙)	1,907,010	8,263,710	6.84	0	无	0	其他
罗伟绍	1,890,000	8,190,000	6.77	8,190,000	无	0	境外自然人
上海超越摩尔私募基金管理有限公司－上海超越摩尔股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-847,159	1,667,284	1.38	0	无	0	其他
富诚海富资管－杭州银行－富诚海富通晶华微员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	203,249	880,744	0.73	0	无	0	其他
深圳芯邦科技股份有限公司	754,965	754,965	0.62	0	无	0	境内非国有法人
刘杰溪	184,745	390,678	0.32	0	无	0	境内自然人
陶勋	79,647	345,137	0.29	0	无	0	境内自然人
张健	108,818	323,778	0.27	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人吕汉泉与罗洛仪系夫妇，罗伟绍与罗洛仪系兄妹关系，罗伟绍为公司实际控制人的一致行动人，景宁晶殷华系吕汉泉实际控制的企业；公司部分高管与核心员工参与战略配售计划。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

存托凭证持有人情况

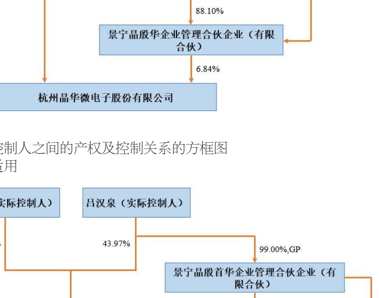
□适用　√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

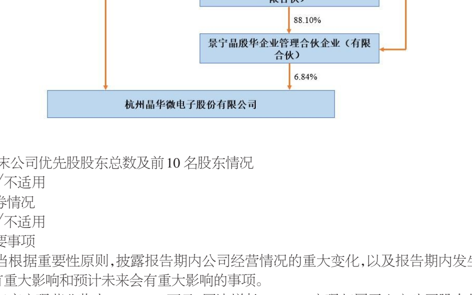
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司2025年度实现营业收入17,358.47万元，同比增长28.73%；实现归属于上市公司股东的净利润为-4,213.89万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,135.94万元。报告期内的公司主要经营情况详见本报告“第三节 二、经营情况讨论与分析”的相关内容。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用